

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
G02F 1/133

(11) 공개번호 특1995-0033588
(43) 공개일자 1995년 12월 26일

(21) 출원번호	특1995-0014109
(22) 출원일자	1995년 05월 27일
(30) 우선권주장	94-115120 1994년 05월 27일 일본(JP)
(71) 출원인	샤프 가부시끼가이샤 쓰지 하루오 일본국 오사카후 오사카시 아베노구 나가이쵸 22방 22고
(72) 발명자	마지마 겐지 일본국 오사카 마쓰바라시 아오 1-4-4
(74) 대리인	이병문, 백덕열, 이태희

심사청구 : 없음

(54) 액정패널 및 그의 제조방법

요약

완성상태의 액정패널의 기판보다도 큰 2매의 베이스 기판을, 상기 2매의 베이스 기판간에 갭을 둔 상태로 중합시키는 공정; 상기 2매의 베이스 기판간의 갭을 광경화성 수지와 액정재료와의 혼합재로 충전하고, 상기 혼합재의 소정 영역에 광을 조사하여 액정재료로 부터 광경화성 수지를 상분리시키면서 광경화성 수지를 경화시켜, 액정영역과 이 액정영역을 포위하는 밀봉부를 형성하고 상기 2매의 베이스 기판을 함께 조립하는 공정; 및 상기 베이스 기판을 다수의 액정패널로 커팅하는 공정을 포함하는 방법에 의해 제조되는 것을 특징으로 하는, 2매의 기판간에 협지되고 액정 재료를 포위하는 밀봉부에 의해 함께 조립되는 상기 2매의 기판간에 액정재료를 함유하는 액정패널이 제공된다.

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

액정패널 및 그의 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 제1실시예의 복수의 액정패널이 얻어지는 조립체의개략 단면도, 제2도는 상기 제1실시예의 액정패널의 제조방법에 있어서 1쌍의 레이스기판상에 화소전극을 형성하는 공정을 보인 개략 단면도, 제3도는 상기 제1실시예의 액정패널의 제조방법에 있어서 광경화성수지와 액정과 혼합재를 1쌍의 베이스기판간에 배치하는 공정을 보인 개략 단면도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

완성상태의 액정패널의 기판보다도 큰 2매의 베이스 기판을, 상기 2매의 베이스 기판간에 갭을 둔 상태로 중합시키는 공정; 상기 2매의 베이스 기판간의 갭을, 광경화성 수지와 액정재료와의 혼합재로 충전하고, 상기 혼합재의 소정 영역에 광을 조사하여 액정재료로 부터 광경화성 수지를 상분리시키면서 광경화성 수지를 경화시켜, 액정영역과 이 액정영역을 포위하는 밀봉부를 형성하고 상기 2매의 베이스 기판을 함께 조립하는 공정; 및 상기 베이스 기판을 다수의 액정패널로 커팅하는 공정을 포함하는 방법에 의해 제조되는 것을 특징으로 하는, 2매의 기판간에 협지되고 액정 재료를 포위하는 밀봉부에 의해 함께 조립되는 상기 2매의 기판간에 액정재료를 함유하는 액정패널.

청구항 2

제1항에 있어서, 밀봉부에 형성되고 그를 통해 혼합재가 주입되는 주입구가 상기 광경화성 수지로 밀봉

되어 있는 액정패널의 제조방법.

청구항 3

2매의 기판간에 협지되고 액정 재료를 포위하는 밀봉부에 의해 함께 조립되는 상기 2매의 기판간에 액정재료를 함유하는 액정패널의 제조방법으로서, 완성상태의 액정패널의 기판보다도 큰 2매의 베이스 기판을, 상기 2매의 베이스 기판간에 갭을 둔 상태로 중합시키는 공정; 상기 2매의 베이스 기판간의 갭을 광경화성 수지와 액정재료와의 혼합재로 충전하고, 상기 혼합재의 소정 영역에 광을 조사하여 액정재료로 부터 광경화성 수지를 상분리시키면서 광경화성 수지를 경화시켜, 액정영역과 이 액정영역을 포위하는 밀봉부를 형성하고 상기 2매 베이스 기판을 함께 조립하는 공정; 및 상기 베이스 기판을 다수의 액정패널로 커팅하는 공정을 포함하는 액정패널의 제조방법.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 밀봉부에 형성된 주입구는 광경화성 수지를 경화시켜 밀봉되는 액정패널의 제조방법.

청구항 5

제3항에 있어서, 상기 밀봉부를 형성한 후 냉각수로 냉각시키면서 함께 조립된 상기 베이스 기판을 복수의 액정패널로 커팅하는 공정을 더 포함하는 액정패널의 제조방법.

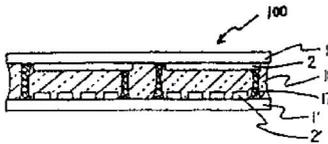
청구항 6

제4항에 있어서, 상기 밀봉부를 형성한 후 냉각수로 냉각시키면서 함께 조립된 상기 베이스 기판을 복수의 액정패널로 커팅하는 공정을 더 포함하는 액정패널의 제조방법.

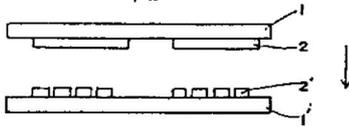
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3

